

# 凝聚态物理-北京大学论坛

2018年第25期 (No. 446 since 2001)

## 中国集成电路制造产业创新发展情况

叶甜春 研究员

时间：11月29日（星期四）15:00—16:30

地点：北京大学物理大楼中212教室

•**摘要：**集成电路作为信息产业最基础的战略产品，其技术的持续高速发展，强力推动着人工智能、量子信息、移动通信、云计算、大数据、物联网、区块链、金融数字化等新兴战略性高科技的发展，保证我国实现网络强国、制造强国、传统产业转型升级发展目标的实现。

•随着集成度的提高，芯片内在结构和生产工艺不断得到更新，集成电路制造业沿着摩尔定律和超越摩尔定律两条路同时演进，持续保持着高速发展，形成了当今集成电路制造业的基础。本报告将讲述集成电路制造业发展趋势和已有基础，进而分析下一步发展面临的挑战和应对策略。

•**报告人简介：**叶甜春，研究员，博士生导师。现任中科院微电子所所长，同时兼任中科院物联网研发中心理事长、中国半导体行业协会副理事长。长期从事集成电路制造、新型器件及微细加工、物联网技术等领域的研究工作。作为负责人完成“七五”至“十五”攻关、攀登计划、863计划、973计划、国家科技重大专项、自然科学基金等二十余项科研项目研究任务。发表论文150多篇，获得发明专利授权121项。1998年获得“国务院特殊津贴”。先后获国家技术发明二等奖3项、中国科学院杰出科技成就奖2项、国家科学技术进步二等奖1项。

•2008年，被国务院任命为国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）专职技术责任人，是国家中长期科技规划16个重大专项的技术总师之一。

邀请人:沈波 bshen@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

<http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forun/2018/2018qiu.xml>